

平成 25 年 3 月 22 日

各 位

会社名 シャープ株式会社
代表者名 取締役社長 奥田 隆 司
(コード番号 6753)

**Qualcomm に対する第 2 次第三者割当増資に係る協議の結果に関するお知らせ
(新払込期日設定に伴う第 2 次第三者割当増資による新株発行のお知らせ)**

当社は、平成 24 年 12 月 4 日のプレスリリース（平成 24 年 12 月 6 日の訂正プレスリリースによる訂正を含め、以下「平成 24 年 12 月 4 日プレスリリース等」といいます。）において、同日開催の取締役会（以下「平成 24 年 12 月 4 日取締役会」といいます。）において、当社と Qualcomm Incorporated（以下「Qualcomm」といいます。）の 100%出資子会社である Pixtronix, Inc.（以下「Pixtronix」といいます。）との間の次世代の MEMS（Micro Electro Mechanical System：微小電子機械システム）ディスプレイの共同開発を目的とする業務提携に関する共同開発契約（以下「共同開発契約」といいます。）及び Qualcomm との間の第三者割当増資に関する出資引受契約（以下「出資契約」といいます。共同開発契約とあわせて、以下「共同開発・出資契約」といいます。）を締結すること、また、当該共同開発・出資契約に基づき、Qualcomm を割当先とする平成 24 年 12 月 27 日を払込期日とする第三者割当（以下「第 1 次第三者割当増資」といいます。）及び平成 25 年 3 月 29 日を払込期日とする第三者割当（以下「旧第 2 次第三者割当増資」といいます。）による新株発行を行うことを決定したことをお知らせしておりましたが、平成 25 年 3 月 18 日のプレスリリースでお知らせしたとおり、旧第 2 次第三者割当増資に関しては、その払込期日までに払込みを受けることができない状況となっております。

共同開発・出資契約に基づき、Qualcomm と継続して協議を行った結果、本日開催の当社取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、旧第 2 次第三者割当増資に代わる Qualcomm に対する第三者割当増資として、新たに平成 25 年 6 月 28 日を払込期日の予定日（後記のとおりこれより前の日が最終的な払込期日となる場合があります。）として設定し、その他の条件は旧第 2 次第三者割当増資と同じである第三者割当増資（以下「第 2 次第三者割当増資」といいます。）を行うことを決定しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 募集の概要

当社は、今後の成長戦略の基本方針として、「所有する様々な技術力、デバイス開発力、商品企画力、販売チャネルなどの強みを活かして、独自の優位性を有する商品を開発し、お客様の感動を呼びおこし、新たな生活を提案する「生活創造企業」を目指すこと」を打ち出しております。

中でも、当社の中小型液晶事業における IGZO 液晶技術を核として、他社に常に先行する新たなディスプレイの開発を通じた技術優位性を維持することにより、搭載商品と顧客の拡大を実現するとともに、収益改善に結び付けていきたいと考えております。

当社は、平成 24 年 12 月 4 日プレスリリース等でお知らせしたとおり、Qualcomm の 100%出資子会社の Pixtronix が保有する MEMS ディスプレイ技術と当社が保有する IGZO-TFT 技術の統合により、次世代の MEMS ディスプレイ（以下「次世代 MEMS ディスプレイ」といいます。）の実用化技術の共同開発を行い将来における実用化に向け取り組むことを目的とする共同開発契約を締結し、また、共同開発契約による提携を確実に推進するため、出資契約を締結しました。

共同開発・出資契約では、次世代 MEMS ディスプレイの共同開発及び実用化技術の研究開発は、二段階で行うものとしています。すなわち、第一段階として、当社は当該次世代 MEMS ディスプレイの開発に関する研究開発及び設備投資を行い、第一段階における実用化技術の開発において、一定の条件（ディスプレイモジュールの製品仕様の確立、設備の導入に関する計画作成及びその他研究開発に必要な資源・体制の確保等の諸条件が完了していることを両社で確認すること、並びに当社が連結ベースで平成 24 年度下期営業黒字化を実現すること、平成 25 年 3 月 31 日付で純資産 1,000 億円及び現預金 1,250 億円を有すること（あるいは平成 25 年 3 月 31 日前に払込みが行われる場合には数値が達成される見込みがあること）が充たされていること。（以下「本追加投資主要条件」といいます。)) が充足した時点で、有価証券届出書に係る訂正届出書（以下「本訂正届出書」といいます。）を提出し、払込期日までに同届出書の効力が生じること（以下「本追加投資条件」といいます。）を条件に第三者割当増資を実施し、実用化技術開発の第二段階に移行することとしております。

かかる共同開発の第二段階に進むための追加資金を調達する目的で、平成24年12月4日取締役会では、旧第2次第三者割当増資を決議し、旧第2次第三者割当増資に係る有価証券届出書を提出しておりました。その後、両社による共同研究を進めてきた結果、両社間で条件充足の確認に向けて協議を継続中であり、本追加投資主要条件の充足の確認に関して、精度及び確実性の高い情報及び状況を前提に慎重に判断するために暫くの時間の猶予が必要であるとの両社認識に至ったことを踏まえて、平成25年3月29日を払込期日とした旧第2次第三者割当増資を一旦取りやめることとし、当該有価証券届出書を平成25年3月22日に取り下げております。

共同開発・出資契約においては、平成 25 年 3 月 29 日までに本追加投資主要条件の充足が困難な場合には、第二段階の共同開発に移ることにつき 3 か月の猶予を設け、平成 25 年 6 月 30 日まで延長するとしていたことから、かかる規定に基づき、両社で協議した結果、共同開発・出資契約における共同開発の第二段階の追加資金に充てる手段として、本取締役会において、旧第2次第三者割当増資に代わるものとして、第2次第三者割当増資を行うことを決定するに至ったものです。第2次第三者割当増資に関しては、上記のとおり、共同開発・出資契約の規定に基づき、本追加投資主要条件が充足したことを確認し、かつ、当該確認を受けて本訂正届出書を提出し、下記払込期日までに同届出書の効力が生じること条件として実施いたします。一方、仮に、本追加投資主要条件が充足しない場合には、当該第三者割当増資は実行されないこととなります。

第2次第三者割当増資

① 払 込 期 日	平成 25 年 6 月 28 日（金）（注） 1
② 発 行 新 株 式 数	未定（注） 2、 3
③ 発 行 価 額	未定（注） 4
④ 調 達 資 金 の 額	未定（注） 5
⑤ 募集又は割当方法 （割当予定先）	第三者割当の方法によります。 発行される株式すべてを Qualcomm に割り当てる予定です。
⑥ そ の 他	<p>※金融商品取引法に基づく第2次第三者割当増資に係る有価証券届出書及び本訂正届出書の効力発生を条件とします。</p> <p>※本取締役会決議では、第2次第三者割当増資に係る諸条件を決定しておりますが、発行数及び払込期日が確定していないため、第2次第三者割当増資に関しては、会社法第 199 条第 1 項に規定する募集株式の発行に係る決定のための取締役会決議を経っておりません。本追加投資主要条件の充足に伴い発行数及び払込期日が確定次第、第2次第三者割当増資につき会社法第 199 条第 1 項で求められる取締役会決議を行う予定です。</p> <p>※共同開発・出資契約において、Qualcomm は、上記払込期日までに共同開発・出資契約に定める本追加投資条件が充足する場合に限り、その払込みを行うこととされています。仮に本追加投資条件が充足しない場合には、第2次第三者割当増資は実行されないこととなります。詳細に関しては下記をご参照ください。</p>

(注) 1. 払込期日については、上記のとおり予定しておりますが、本追加投資主要条件が充足し、下記(注) 3及び4記載の方法に従い当社取締役会で発行新株式数及び発行価額を決定した日(以下「本第三者割当増資条件確定日」といいます。)に正式に決定する予定であります。この点、上記のとおり、本追加投資主要条件の充足に関しては両社で協議中であるものの、本追加投資主要条件の充足につき両社で合理的に満足できる形で確認できる時点に関しては、現時点では一義的に決められないため、両社での協議を踏まえて、共同開発・出資契約において第二段階の共同開発に移ることの猶予期間である平成25年6月30日までににおける最終日(ただし払込受領との関係で金融機関休業日である平成25年6月29日及び30日を除きます。)である平成25年6月28日を払込期日の予定日としています。なお、当該日前であっても、本追加投資主要条件の充足が確認出来次第、共同開発・出資契約に基づき、可及的速やかに本訂正届出書を提出し、本訂正届出書の効力が発生次第速やかに第2次第三者割当増資を実施いたします。本追加投資主要条件に関して精度及び確実性の高い情報及び状況に基づき両社が合理的に満足する形で確認することができることになると見込まれる日以降の各日において本第三者割当増資条件確定日となった場合の払込期日は下記のとおりとなります。

本第三者割当増資条件確定日	払込期日
平成25年3月23日乃至同年3月25日	平成25年4月10日
平成25年3月26日	平成25年4月11日
平成25年3月27日	平成25年4月12日
平成25年3月28日及び同年3月29日	平成25年4月15日
平成25年3月30日乃至同年4月1日	平成25年4月17日
平成25年4月2日	平成25年4月18日
平成25年4月3日	平成25年4月19日
平成25年4月4日及び同年4月5日	平成25年4月22日
平成25年4月6日乃至同年4月8日	平成25年4月24日
平成25年4月9日	平成25年4月25日
平成25年4月10日	平成25年4月26日
平成25年4月11日及び同年4月12日	平成25年4月30日
平成25年4月13日乃至同年4月15日	平成25年5月1日
平成25年4月16日	平成25年5月2日
平成25年4月17日乃至同年4月19日	平成25年5月7日
平成25年4月20日乃至同年4月22日	平成25年5月8日
平成25年4月23日	平成25年5月9日
平成25年4月24日	平成25年5月10日
平成25年4月25日及び同年4月26日	平成25年5月13日
平成25年4月27日乃至同年4月30日	平成25年5月16日
平成25年5月1日	平成25年5月17日
平成25年5月2日	平成25年5月20日
平成25年5月3日乃至同年5月7日	平成25年5月23日
平成25年5月8日	平成25年5月24日
平成25年5月9日及び同年5月10日	平成25年5月27日
平成25年5月11日乃至同年5月13日	平成25年5月29日
平成25年5月14日	平成25年5月30日
平成25年5月15日	平成25年5月31日
平成25年5月16日及び同年5月17日	平成25年6月3日
平成25年5月18日乃至同年5月20日	平成25年6月5日
平成25年5月21日	平成25年6月6日
平成25年5月22日	平成25年6月7日
平成25年5月23日及び同年5月24日	平成25年6月10日
平成25年5月25日乃至同年5月27日	平成25年6月12日
平成25年5月28日	平成25年6月13日
平成25年5月29日	平成25年6月14日

本第三者割当増資条件確定日	払込期日
平成25年5月30日及び同年5月31日	平成25年6月17日
平成25年6月1日乃至同年6月3日	平成25年6月19日
平成25年6月4日	平成25年6月20日
平成25年6月5日	平成25年6月21日
平成25年6月6日及び同年6月7日	平成25年6月24日
平成25年6月8日乃至同年6月10日	平成25年6月26日
平成25年6月11日	平成25年6月27日
平成25年6月12日	平成25年6月28日

第2次第三者割当増資は、上記各払込期日において本追加投資条件の充足が維持されていることを条件に実行されます。

2. 第2次第三者割当増資により発行する株式に関し、平成25年6月開催予定の当社定時株主総会に係る議決権の付与はいたしません。
3. 発行新株式数は、発行価額の総額として予定している60百万USドルを発行価額確定の時点の為替レートにより日本円に換算した額（1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。）（以下「発行価額予定額」といいます。）を、1株あたりの発行価額（（注）4参照）で除した数（1,000株未満の数が生じたときはこれを切り捨てます。）となる予定です。この算定方法は、旧第2次第三者割当増資と同じです。
4. 発行価額は、本取締役会において次のとおり決定しております。
本追加投資主要条件が充足した日（以下「追加投資主要条件充足日」といいます。）の2営業日前の日から遡った20営業日間の株式会社東京証券取引所における当社の終値の単純平均値（1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げます。）に相当する価格とします。この算定方法は、旧第2次第三者割当増資と同じです。
5. 発行新株式数に発行価額を乗じた額となります。

なお、平成24年12月27日に払込みが完了している第1次第三者割当増資の概要につきましては、後記「10.（4）最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況」をご参照ください。

2. 募集の目的及び理由

当社を取り巻く事業環境は円高に加え、主要事業である液晶事業における価格競争の激化などにより、厳しさを増しております。このような厳しい環境の下、事業構造改革の一環として、当社の最先端技術であるIGZO-TFT 技術など競争優位性を有する中小型液晶事業を今後の当社の成長エンジンと位置づけ、伸長が見込まれるモバイル機器用ディスプレイ市場などに向け、IGZO 液晶搭載商品の拡大、顧客の拡大を実現することにより、収益の拡大に取り組んでおります。しかしながら、モバイル機器向けのディスプレイにおいても技術開発競争と価格競争が熾烈化しており、当社の市場における地位を維持・向上するためには、新たな技術開発を継続する必要があります。

中小型液晶事業のターゲットであるスマートフォン、タブレット端末などのモバイル機器の市場は、その拡大が進むにつれ、搭載するディスプレイにも更なる視認性の高さや低消費電力化が求められることが見込まれています。そこで、このたび、当社は、平成24年12月4日プレスリリース等でお知らせしたとおり、当社が保有するIGZO-TFT 技術とPixtronix が保有するMEMS ディスプレイ技術を持ち寄り、更なる画質の向上と低消費電力を実現するモバイル機器向け次世代MEMS ディスプレイの共同開発を目的とした共同開発・出資契約を締結することで合意しております。

当社は、これによりMEMS ディスプレイが優位性を持つと考える色再現性に加え、IGZO-TFT 技術の特長である高速応答と低消費電力を生かすことによって、世界初になると考えられるMEMS ディスプレイの開発と実用化を効率的に実現することが可能となり、技術開発競争と価格競争が厳しい経営環境においても、品質の向上を確保することで安定的な収益確保については当社の企業価値の向上に結び付けられる、と考えております。

このように、Pixtronix の MEMS ディスプレイ技術はかかるモバイル機器向け次世代 MEMS ディスプレイの共同開発のため不可欠な技術と考えており、同社と共同開発契約を締結し、パートナーとすることは両社にとって大きなメリットをもたらすものとの結論に達したものです。また、これに伴い、Pixtronix との共同開発契約による提携を確実に推進するため、同社の親会社である Qualcomm を割当予定先とした第 1 次第三者割当増資及び第 2 次第三者割当増資を実施することを決定したものです。

一方、平成 24 年 11 月 1 日公表の平成 25 年 3 月期第 2 四半期決算及び平成 25 年 2 月 1 日公表の平成 25 年 3 月期第 3 四半期決算において継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、幅広い対応策を実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと考えます。しかしながら、平成 24 年 12 月末現在の自己資本比率は、9.6%まで低下するに至っており、第 2 次第三者割当増資は、財務体質改善に向け、当社の資本政策上も有意義なものであると判断しております。また、今後の資本政策については、当社の財務状況に鑑みて、今後の資本の充実に向けたしかるべき検討を行い、企業価値の向上に努めてまいります。

また、当社は、新たな事業構造改革の一環として、特に液晶事業の収益力改善・安定化に向けた改革を継続的に推進しており、その具体的な施策として、第 1 次第三者割当増資及び第 2 次第三者割当増資に加えて、鴻海精密工業股份有限公司等との包括的な協業を通じた収益の改善・安定化を企図した平成 24 年 3 月 27 日にお知らせした鴻海精密工業股份有限公司等を割当予定先とする第三者割当増資（以下「平成 24 年 3 月 27 日決議第三者割当増資」といいます。）、及び、平成 25 年 3 月 6 日にお知らせした SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

（以下「サムスン電子」という。）への液晶パネルの安定的かつ確実な供給を通じた収益の改善・安定化を企図したサムスン電子の日本法人であるサムスン電子ジャパン株式会社（以下「サムスン電子ジャパン」といいます。）を割当予定先とする第三者割当増資（以下「平成 25 年 3 月 6 日決議第三者割当増資」といいます。）に取り組んでおります。なお、平成 24 年 3 月 27 日決議第三者割当増資に関しては、払込期日が平成 25 年 3 月 26 日と迫っておりますが、現時点で払込みの実施に関してはまだ協議中です。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

①	払込金額の総額	未定(注)1
②	発行諸費用の概算額	未定(注)2
③	差引手取概算額	未定(注)3

- (注) 1. 前記「1. 募集の概要 第2次第三者割当増資」記載の発行価額に発行新株式数を乗じた額になります。なお、当該払込金額の総額は、発行価額予定額に近い額となると見込まれております。
2. 発行諸費用には、登記費用、弁護士及び財務アドバイザー費用、取引所上場関係費用などが見込まれますが、払込金額の総額が未定のため、発行諸費用の概算額も未定です。
3. 払込金額の総額から発行諸費用の概算額を控除した額になります。

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

上記差引手取概算額の具体的な使途については、次のとおり予定しております。また、以下の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等で保管する予定です。

具体的な使途	金額	支出予定時期
次世代MEMSディスプレイ生産技術開発経費(注)1	未定	平成25年6月～ 平成26年12月
次世代MEMSディスプレイ生産技術開発用設備投資(注)1	未定	平成25年6月～ 平成26年12月

- (注) 1. 当社は、次世代MEMSディスプレイの実用化の技術開発に目処が付き次第、実用化に必要な生産ラインその他必要な生産設備を設置することを予定しており、上記の手取金はそのために必要な設備投資に充当する予定です。
2. 前記「1. 募集の概要」に記載のとおり、第2次第三者割当増資は、本追加投資主要条件を充足せず、次世代MEMSディスプレイの研究開発の成功の見込みが明らかに認められないような場合には、上記「具体的な使途」に記載の資金は不要になることから、第2次第三者割当増資は実行されず、この場合、上記の次世代MEMSディスプレイの開発及び実用化に必要な技術を確立するための研究開発も実施されません。
3. 第2次第三者割当増資に関しては、発行数の確定後、本訂正届出書を提出し、その効力が生じない限り実施されませんので、上記はあくまで本日時点での見込みとなります。
4. 上記具体的な使途にかかる各金額に関しては、発行価額が現時点で未定であるため未定としておりますが、最終的に本追加投資主要条件の充足が確認され発行価額の総額が確定した場合にはその全額を上記各資金使途に充当する予定です。

当社は、新たな事業構造改革の一環として、特に液晶事業の収益力改善・安定化に向けた改革を推進しており、その具体的な施策として、当該分野における技術やプロダクトの競争力強化並びに製造・生産等の事業効率の向上を企図した継続的な設備投資等を今後予定しております。

その一環として、モバイル機器向け液晶製造プロセスの内製化を目的とする製造設備の合理化、及び液晶ディスプレイの画素密度の高精細化のための新規技術導入に係わる投資等を計画しており、当該計画の実行に際して必要な資金を調達するため、平成24年3月27日決議第三者割当増資及び平成25年3月6日決議第三者割当増資を決議しております。

一方、第1次第三者割当増資及び第2次第三者割当増資は、次世代MEMSディスプレイパネル技術・実用化技術の確立のための開発投資等を計画しており、当該計画の実行に際して必要な資金を調達することを目的としているため、これらは平成24年3月27日決議第三者割当増資及び平成25年3月6日決議第三者割当増資とは異なる資金使途に基づいて行われるものです。

以上のとおり、第2次第三者割当増資は当社の資本政策に資するものですが、払込みが完了していない平成24年3月27日決議第三者割当増資または平成25年3月6日決議第三者割当増資に代わる資本政策として位置づけるものではありません。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

スマートフォン、タブレット端末などのモバイル機器の市場拡大が進むにつれ、搭載するディスプレイにも更なる視認性の高さや低消費電力化が求められています。MEMS ディスプレイの特長である高い色再現性にIGZO-TFT 技術の特長である高速応答かつ低消費電力などを生かした次世代の高付加価値ディスプレイを開発することは、当社が今後成長を持続するために不可欠であり、中長期的な当社グループの企業価値及び株主利益の向上に寄与すると見込まれるため、そのための研究開発及び設備投資費用である当該資金使途には合理性があるものと判断しております。

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

第2次第三者割当増資の払込金額につきましては、本取締役会において、追加投資主要条件充足日の2営業日前の日から遡った20営業日間の株式会社東京証券取引所における当社の終値の単純平均値（1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げます。）とすることに決定いたしました。この算定方法は、旧第2次第三者割当増資と同じです。

追加投資主要条件充足日の2営業日前の日から遡った20営業日間の終値の単純平均値を参考としたのは、第2次第三者割当増資に係る払込期日が一定期間先の将来の日となっていることを考慮すると、適正な払込金額水準に関しては前もって決定することが適切ではない面もあり、第2次第三者割当増資の払込金額についてその発行直前の比較的短期間の株価水準を参考にしたほうがよいと考えたためです。また、当社の株価は、ここ1年ほどの間、昨今の業績不振や通期計画の下方修正を受けてそれ以前の市場価格と比べて大幅に下落した水準となる等、現状の株価は変動が大きかったことに鑑みると、特定の日における価格のみを参考にするよりも、価格決定時の直近の比較的短期間の平均値を参考とすることの方が妥当と判断したためです。

本払込金額が有利発行に当たらないかどうかの判断に関しては、本日時点では、その判断の前提となる払込金額が確定していないことから、払込金額が確定した時点で判断する予定です。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

第1次第三者割当増資により、本割当予定先に対して割り当てた当社普通株式の数量30,120,000株は、平成25年3月21日現在の当社普通株式の発行済株式総数1,140,819,887株から第1次第三者割当増資により発行した当社普通株式の数量30,120,000株を除いた1,110,699,887株に対して2.71%（議決権総数1,095,302個（注）に対する割合2.75%）となり、さらにこれに追加して、第2次第三者割当増資により本割当予定先に対して当社普通株式が割り当てられる予定です。

しかしながら、前記「2. 募集の目的及び理由」及び「3. (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」に記載のとおり、第1次第三者割当増資により調達する資金は、当社の優位性及び成長性を確保する上で重要となるモバイル機器向けの次世代MEMSディスプレイの共同開発に係わる投資等に充当することで、当社グループの中長期的な収益力向上及び競争力強化に資するものであり、ひいては中長期的な当社グループの企業価値及び株主利益の向上に寄与するものであることから、第1次第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。なお、平成24年3月27日決議第三者割当増資により鴻海精密工業股份有限公司等に割り当てる予定の当社普通株式の数量121,649,000株、第1次第三者割当増資によりQualcommに割り当てた当社普通株式の数量30,120,000株及び平成25年3月6日決議第三者割当増資によりサムスン電子ジャパンに対して割り当てる予定の当社普通株式の数量35,804,000株の総数187,573,000株は、平成25年3月21日現在の当社普通株式の発行済株式総数1,140,819,887株から第1次第三者割当増資により発行した当社普通株式の数量30,120,000株を除いた1,110,699,887株に対して16.89%（議決権総数1,095,302個（注）に対する割合17.13%）となっております。

（注）議決権総数は発行済株式総数1,140,819,887株から、平成24年9月30日時点の株主名簿に基づく単元未満株式4,939,887株、自己保有株式（単元未満株式を除く）10,383,000株及び相互保有株式75,000株並びに第1次第三者割当増資により発行した当社普通株式の数量30,120,000株を控除して算出したものです。

第2次第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であるかどうかに関しては、本日時点では、その判断の前提となる発行価額が確定していないことから、発行価額が確定した時点で判断し、判断の内容については改めて開示する予定です。

6. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

①	名 称	Qualcomm Incorporated		
②	所 在 地	アメリカ合衆国 カリフォルニア州 92121 サンディエゴ モアハウス・ドライブ 5775 (5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, U.S.A.)		
③	代表者の役職・氏名	Chairman of the Board and Chief Executive Officer Paul E. Jacobs		
④	事 業 内 容	CDMA (符号分割多重接続) 技術を使う各種の移動通信システムや端末向けのベースバンド・チップセットの開発・販売、及びCDMAに係るライセンスの供与等		
⑤	資 本 金	171,600 US ドル (2012年12月30日現在) (なお、払込資本は12,282百万USドル)		
⑥	設 立 年 月 日	1985年7月1日		
⑦	発 行 済 株 式 数	1,718,129,898 株 (2013年1月28日現在)		
⑧	決 算 期	9月		
⑨	従 業 員 数	約26,600名 (2012年9月30日現在)		
⑩	主 要 取 引 銀 行	Bank of America Corporation		
⑪	主 要 取 引 先	Samsung Electronics Co. Ltd. Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.		
⑫	大株主及び持株比率	BlackRock Advisors, LLC	6.12%	
		The Vanguard Group, Inc.	4.35%	
		State Street Global Advisors (SSgA)	4.00%	
		Fidelity Management & Research Company	3.41%	
		T. Rowe Price Associates, Inc.	2.77%	
⑬	当事会社間の関係			
	資 本 関 係	当該会社は当社の普通株式30,120,000株(平成24年12月31日現在の発行済株式総数1,140,819,887株に対する割合は2.64%)を保有しております。当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取 引 関 係	当社は、割当予定先との間で、携帯電話(スマートフォン)用チップセットの購買等に関する取引関係があります。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
⑭	最近3年間の経営成績及び財政状態			
決 算 期		2010年9月期	2011年9月期	2012年9月期
連 結 純 資 産		20,858百万USドル (1,737,889百万円)	26,972百万USドル (2,068,752百万円)	33,545百万USドル (2,602,253百万円)
連 結 総 資 産		30,572百万USドル (2,547,259百万円)	36,422百万USドル (2,793,567百万円)	43,012百万USドル (3,336,656百万円)
1株当たり連結当期純資産		12.70 USドル (1,058円)	16.27 USドル (1,248円)	19.73 USドル (1,531円)
連 結 売 上 高		10,982百万USドル (915,020百万円)	14,957百万USドル (1,147,202百万円)	19,121百万USドル (1,483,312百万円)
連 結 営 業 利 益		3,727百万USドル (310,534百万円)	5,026百万USドル (385,494百万円)	5,682百万USドル (440,781百万円)
連 結 当 期 純 利 益		3,247百万USドル (270,540百万円)	4,260百万USドル (326,742百万円)	6,109百万USドル (473,906百万円)
1株当たり連結当期純利益		1.98 USドル (165円)	2.57 USドル (197円)	3.59 USドル (278円)
1株当たり配当金		0.72 USドル (60円)	0.81 USドル (62円)	0.93 USドル (72円)

- (注) 1. 上記の円表記は、1 US ドルを、2010年9月期は、平成22年(2010年)9月30日の東京外国為替市場終値 83.32 円、2011年9月期は、平成23年(2011年)9月30日の東京外国為替市場終値 76.70 円、2012年9月期は、平成24年(2012年)9月28日の東京外国為替市場終値 77.575 円にて換算しております。
2. 本割当予定先である Qualcomm は、米国 NASDAQ 証券取引所に上場しております。米国では、反社会的行為を規制する The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act が存在し、Qualcomm は米国 NASDAQ 証券取引所上場企業として同規則によりこうした法令の遵守の徹底を求められていること、また、当社は、割当予定先である Qualcomm から、同社の知る限り、同社の役員及び主要株主が暴力団等とは一切関係がない旨の表明を取得しております。これらのことにより、当社は、本割当予定先が暴力団等とは一切関係がないと判断しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所に提出しております。
3. 平成24年12月4日プレスリリース等でご報告したとおり、Qualcomm の100%出資子会社である Pixtronix と次世代 MEMS ディスプレイの共同開発を目的とする共同開発契約を締結しております。

(2) 割当予定先を選定した理由

前記「2. 募集の目的及び理由」をご参照ください。

(3) 割当予定先の保有方針

本割当予定先である Qualcomm とは出資契約を締結しており、同契約において下記のとおり譲渡制限に同意しており、第2次第三者割当増資により割り当てる当社普通株式の保有方針について、当社の安定株主及び次世代 MEMS ディスプレイの共同研究に係る事業パートナーとして継続的に保有する方針であることを確認しています。

また、共同開発・出資契約において、本割当予定先である Qualcomm は、第1次第三者割当増資が実施された日及び第2次第三者割当増資が実施された日からそれぞれ1年間は、当社の事前の書面による承諾がある場合及び当社による共同開発・出資契約等に関する重大な契約違反がある場合を除き、それぞれの第三者割当増資により割り当てる当社普通株式の全部又は一部を第三者に譲渡しないことに合意しております。

また、本割当予定先である Qualcomm は、共同開発・出資契約において、第1次第三者割当増資及び第2次第三者割当増資のそれぞれの払込日から1年経過した日以降2年間までの間に、その保有する当社の株式を、取引市場で売却する場合には一定の売却数量制限に服するものとし、また、取引市場外で第三者に譲渡しようとする場合には、当社に対して30日前に通知を行い、当社と売却先及び売却条件について協議し、当社が所定の条件を充たす売却先を指定した場合には当該売却先に売却することについて合意しております。

なお、当社は、本割当予定先である Qualcomm より、第2次第三者割当増資の割当日から2年以内に当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に報告すること、並びに当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所に報告すること及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。なお、第1次第三者割当増資に係る確約書はすでに取得済みです。

(4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社としては、本割当予定先である Qualcomm から開示された Qualcomm の直近(2013年9月期第1四半期)を含む財務諸表を確認しております。これらによれば、Qualcomm の2012年12月30日付の連結財務諸表においては、総資産 44,841 百万 US ドル、純資産 35,354 百万 US ドル並びに現金・預金及び現金同等物 4,293 百万 US ドルとなっております。これらにより Qualcomm が十分な資金力を有していることが確認できることから、第2次第三者割当増資の払込みについて問題はないと判断しております。

7. 募集後の大株主及び持株比率

第2次第三者割当増資の大株主及び持株比率に関しては、本日時点では、発行新株式数が確定していないことから、発行新株式数が確定した時点で開示する予定です。

8. 今後の見通し

第2次第三者割当増資が平成25年3月期の連結業績に与える影響につきましては、軽微であります。また、平成26年3月期の連結業績に与える影響につきましては、当該業績見通し公表時に織り込んで開示する予定です。

なお、第2次第三者割当増資に関し今後開示すべき事実が生じましたら、速やかに開示いたします。

9. 企業行動規範上の手続に関する事項

第2次第三者割当増資に関しては、現時点で発行新株式数が確定していないため、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条、株式会社大阪証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第2条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続の要否は未定です。

10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（連結）

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
売上高	2,755,948 百万円	3,021,973 百万円	2,455,850 百万円
営業利益又は営業損失(△)	51,903 百万円	78,896 百万円	△37,552 百万円
経常利益又は経常損失(△)	30,995 百万円	59,124 百万円	△65,437 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)	4,397 百万円	19,401 百万円	△376,076 百万円
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)	4.00 円	17.63 円	△341.78 円
1株当たり配当金	17.00 円	17.00 円	10.00 円
1株当たり純資産	949.19 円	932.46 円	568.83 円

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成25年3月21日現在）

	株式数	発行済普通株式数に対する比率
発行済株式数	1,140,819,887 株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数	79,018,964 株	6.9%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—	—
上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—	—

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
始値	799 円	1,172 円	824 円
高値	1,253 円	1,260 円	842 円
安値	771 円	626 円	467 円
終値	1,169 円	825 円	604 円

(注) 株価は東京証券取引所市場第一部による。

② 最近6か月間の状況

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
始 値	195 円	167 円	170 円	310 円	326 円	295 円
高 値	198 円	181 円	372 円	352 円	357 円	356 円
安 値	142 円	147 円	170 円	281 円	286 円	294 円
終 値	172 円	172 円	303 円	311 円	294 円	308 円

- (注) 1. 株価は東京証券取引所市場第一部による。
2. 平成25年3月の株価については、平成25年3月21日現在で表示しております。

③ 発行決議日前取引日における株価

	平成25年3月21日
始 値	309 円
高 値	310 円
安 値	306 円
終 値	308 円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

平成24年3月27日決議第三者割当増資（払込期間：平成24年5月31日から平成25年3月26日まで）を平成24年3月27日に公表しておりますが、本日現在払込みはなされておられません。なお、当社は割当予定先との間で協議を継続しております

また、当社は、平成25年3月6日決議第三者割当増資（払込期日：平成25年3月28日）を平成25年3月6日に公表しておりますが、本日現在払込みはなされておられません。

なお、第1次第三者割当増資（払込期日：平成24年12月27日）については、払込みを完了しております。各第三者割当増資公表時の募集内容等は以下のとおりであります。

<平成24年3月27日決議第三者割当増資>

払 込 期 間	平成24年5月31日から平成25年3月26日まで
調 達 資 金 の 額	66,466,950,000 円（差引手取概算額）
発 行 価 額	1株につき550円
募集時における発行済株式総数	1,110,699,887株
当該募集による発行株式数	121,649,000株
募集後における発行済株式総数	1,232,348,887株
割 当 予 定 先	鴻海精密工業股份有限公司 50,000,000株 鴻準精密工業股份有限公司 8,029,000株 FOXCONN (FAR EAST) Limited 31,143,000株 Q-Run Holdings Limited 32,477,000株
発行時における当初の資金使途	モバイル機器関連の液晶製造設備の増強・合理化、及び液晶ディスプレイの新規技術導入に係わる投資等
発行時における支出予定時期	平成24年5月～平成26年4月
現時点における充当状況	該当事項はありません。

<第1次第三者割当増資>

払 込 期 日	平成24年12月27日
調 達 資 金 の 額	4,711,680,000 円（差引手取概算額）
発 行 価 額	1株につき164円
募集時における発行済株式総数	1,110,699,887株
当該募集による発行株式数	30,120,000株
募集後における発行済株式総数	1,140,819,887株
割 当 先	Qualcomm Incorporated 30,120,000株
発行時における当初の資金使途	次世代MEMSディスプレイの開発経費及び開発用設備投資
発行時における支出予定時期	平成24年12月～平成25年3月
現時点における充当状況	当初の資金使途に従い一部充当しております。

<平成25年3月6日決議第三者割当増資>

払 込 期 日	平成25年3月28日
調 達 資 金 の 額	10,134,160,000円 (差引手取概算額)
発 行 価 額	1株につき290円
募集時における発行済株式総数	1,140,819,887株
当該募集による発行株式数	35,804,000株
募集後における発行済株式総数	1,176,623,887株
割 当 予 定 先	サムスン電子ジャパン株式会社 35,804,000株
発行時における当初の資金用途	液晶ディスプレイの高精細化のための新規技術導入、タブレット端末や高精細ノートパソコンといったモバイル機器関連の液晶製造設備の合理化等に係る投資等
発行時における支出予定時期	平成25年4月～平成27年3月
現時点における充当状況	該当事項はありません。

1.1. 発行要項

- (1) 募 集 株 式 の 数 未定 (注) 1
 - (2) 払 込 金 額 未定 (注) 2
 - (3) 払 込 金 額 の 総 額 未定 (注) 3
 - (4) 増加する資本金の額 未定 (注) 4
 - (5) 増加する資本準備金の額 未定 (注) 5
 - (6) 募集又は割当方法 第三者割当の方法による。
(割当予定先及び
割当予定株数)
(発行される株式すべてをQualcommに割り当てる予定です。)
 - (7) 払 込 期 日 平成25年6月28日 (金) (注) 6
 - (8) そ の 他 ※金融商品取引法に基づく第2次第三者割当増資に係る有価証券届出書及び本訂正届出書の効力発生を条件とします。
※本取締役会決議では、第2次第三者割当増資に係る諸条件を決定しておりますが、発行数及び払込期日が確定していないため、第2次第三者割当増資に関しては、会社法第199条第1項に規定する募集株式の発行に係る決定のための取締役会決議を経ておりません。本追加投資主要条件の充足に伴い発行数及び払込期日が確定次第、第2次第三者割当増資につき会社法第199条第1項で求められる取締役会決議を行う予定です。
※共同開発・出資契約において、Qualcommは、上記払込期日までに共同開発・出資契約に定める本追加投資条件が充足する場合に限り、その払込みを行うこととされています。仮に本追加投資条件が充足しない場合には、第2次第三者割当増資は実行されないこととなります。
- (注) 1. 募集株式の数は、発行価額予定額を、1株あたりの発行価額 ((注) 2参照) で除した数 (1,000株未満の数が生じたときはこれを切り捨てます。) となる予定です。なお、かかる算式により算出された第2次第三者割当増資による発行数が、第1次第三者割当増資によって発行された株式数とあわせて当社の発行済株式総数の10%以上となる場合には、割当予定先と協議を行うことになっております。この算定方法は、旧第2次第三者割当増資と同じです。
2. 払込金額は発行価額と同額であり、発行価額は、本取締役会において次のとおり決定しております。本追加投資主要条件充足日の2営業日前の日から遡った20営業日の間の株式会社東京証券取引所における当社の終値の単純平均値 (1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げます。) に相当する価格とします。この算定方法は、旧第2次第三者割当増資と同じです。
3. 払込金額 ((注) 2) に募集株式の数 ((注) 1) を乗じた金額になります。
4. 払込金額の総額 ((注) 3) を2で除した額 (1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げます。) となります。
5. 払込金額の総額 ((注) 3) から増加する資本金の額 ((注) 4) を控除した額となります。
6. 払込期日に関しては、前記「1. 募集の概要」における「第2次第三者割当増資」の欄における(注) 1をご参照ください。

以 上